

2008年8月5日

京セラ株式会社 事業説明会

代表取締役社長
川村 誠

京セラ株式会社

本日のプレゼンテーション

1. 2009年3月期 第1四半期 連結業績 第2四半期以降の取組み

代表取締役社長 川村 誠

2. 半導体部品事業の展開

半導体部品事業本部長 久芳 徹夫

3. 情報機器事業の展開

京セラミタ株式会社 代表取締役社長 駒口 克己

将来予想に関する注意事項

この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものであります。これらの将来予想に関する記述は、既知及び未知のリスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。かかるリスク、不確実な要因及びその他の要因は以下のものを含みますが、これらに限られるものではありません。(1)当社が関連する市場の状況(特に、日本、米国、欧州及びアジア(中国を含む)の経済状況)。(2)中国における経済・政治・法律面での条件の予測し得ない変化。(3)競争の厳しいセラミック、半導体部品及び電子部品市場における当社の、革新的な製品を開発・生産し、品質・納期を含めて、顧客の要求に沿った先進技術を投入する能力。(4)生産高や業績に影響を与える社外委託工程や自社内製造過程で生じる遅れや不具合の発生。(5)円高、政治的・経済的な不安定状態、輸出売掛金の回収の困難性、製品の価格競争力の低下、輸送経費の増大、海外事業所管理の問題、知的財産権の保護の不十分性等輸出に影響する可能性がある要素。(6)当社の売上高の相当な部分を構成している通貨(特に米ドル及びユーロ)と円との為替レート。(7)技術力を有する科学・技術その他の分野の人材の不足。(8)当社の機密保持及び特許等の知的財産権の保護の確保。(9)当社製品を継続的に製造・販売する為に必要となるライセンスの安定的確保。(10)生産及び開発能力の拡大、もしくは現在進行中の研究開発が期待される成果を生み出さない場合。(11)当社が取得した会社または資産に関連して想定以上の統合費用がかかり、期待される収益またはビジネスチャンスが得られない場合。(12)テロ行為、疾病の発生、その他当社の市場やサプライチェーンに混乱を与える可能性のある要素。(13)当社の製造施設その他主要な事業関連施設がある地域における地震などの自然災害の発生。(14)国内外の環境規制強化に伴う当社の賠償責任や順守義務の増大。(15)保有する有価証券その他の資産の時価の変動、減損処理の発生及び会計基準の変更。かかるリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開または財務状況は、これらの将来予想に関する記述に明示または包含される将来の業績、事業活動、展開または財務状況と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。

2009年3月期 第1四半期 連結業績

(単位:百万円)

	2008年3月期 第1四半期		2009年3月期 第1四半期		前年同期比 増減率(%)
	金額	売上高比(%)	金額	売上高比(%)	
売上高	315,450	100.0	331,758	100.0	5.2
営業利益	31,616	10.0	27,962	8.4	-11.6
税引前四半期純利益	40,484	12.8	36,905	11.1	-8.8
四半期純利益	24,984	7.9	21,962	6.6	-12.1
希薄化後1株当たり 四半期純利益(円)	131.93	—	115.82	—	-12.2
設備投資額	15,044	4.8	17,967	5.4	19.4
減価償却費	16,281	5.2	19,251	5.8	18.2
研究開発費	15,315	4.9	16,914	5.1	10.4
平均為替レートの	対ドル: 121円	対ユーロ: 163円	対ドル: 105円	対ユーロ: 163円	
為替の変動による 影響額 (前年同期比)	売上高	140億円	-208億円		
	税引前 四半期純利益	54億円	-29億円		

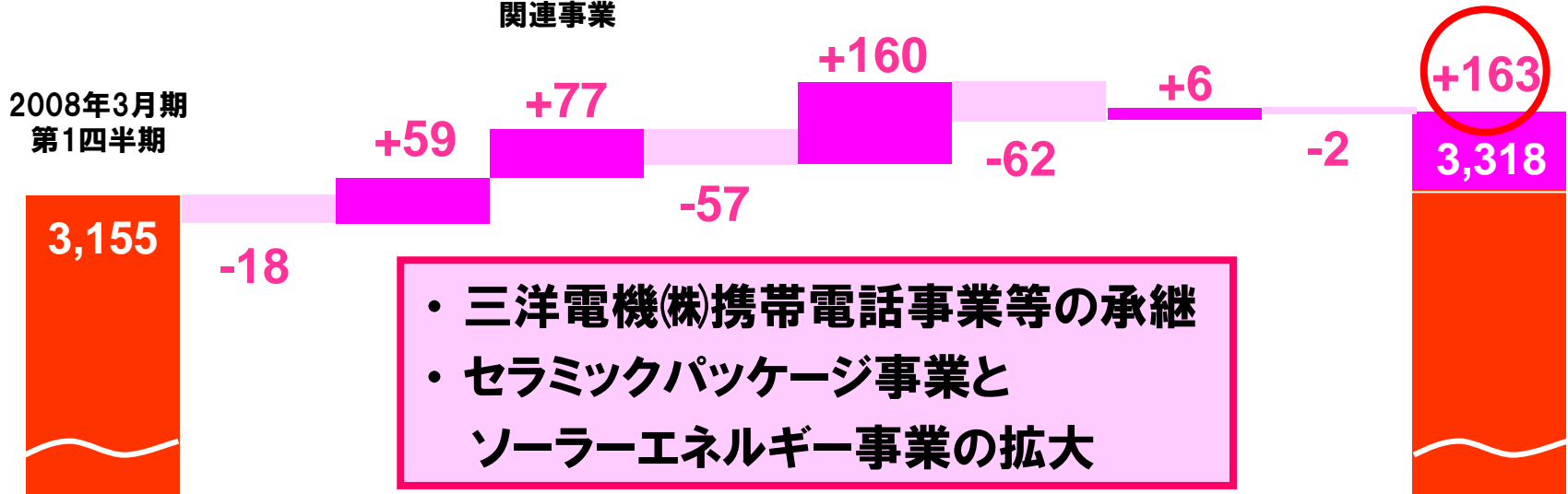
2009年3月期 第1四半期 セグメント別売上高・税引前四半期純利益

—前年同期比増減額—

(単位:億円)

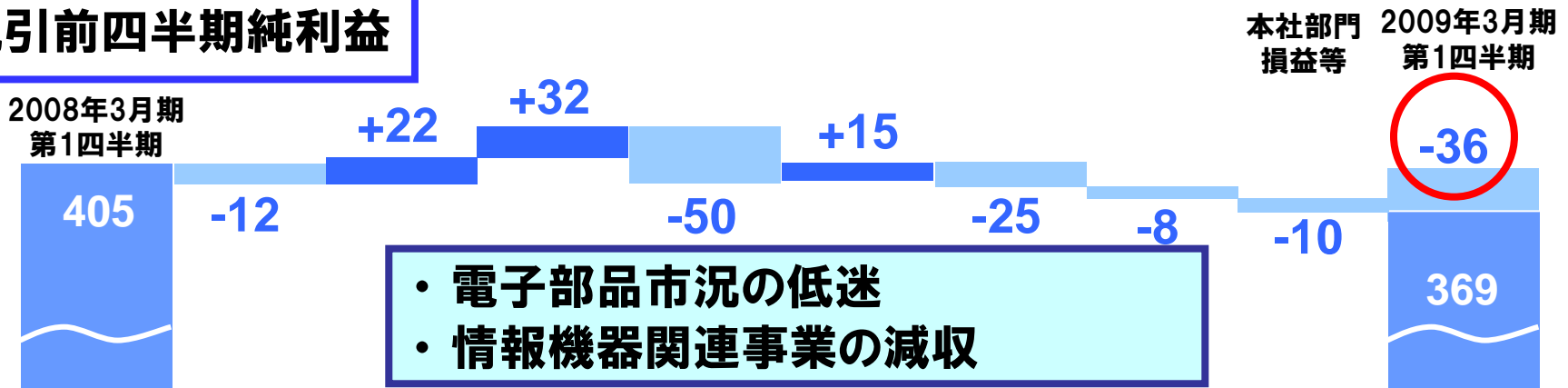
売上高

ファインセラミック部品関連事業
 半導体部品関連事業
 ファインセラミック応用品関連事業
 電子デバイス関連事業
 通信機器関連事業
 情報機器関連事業
 その他の事業
 調整及び消去
 2009年3月期 第1四半期



- ・ 三洋電機(株)携帯電話事業等の承継
- ・ セラミックパッケージ事業とソーラーエネルギー事業の拡大

税引前四半期純利益



- ・ 電子部品市況の低迷
- ・ 情報機器関連事業の減収

本社部門 損益等

2009年3月期 事業環境見通し

世界の主要電子機器の生産台数見通し

(当社予想)

	CY07 (百万台)	CY08見通し (CY07比増減率)	背景
携帯電話端末	1,150	+10%	・ 新興市場における 低価格モデルの需要増
パーソナル コンピュータ	260	+10%	・ ノートPCを中心に 堅調な需要拡大が継続
薄型テレビ	95	+20~30%	・ 大型テレビの需要増

部品単価の動向

年間で前期比15%前後の下落 (例:セラミックコンデンサ)

2009年3月期 連結業績予想

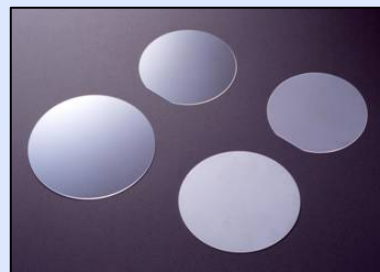
(単位:百万円)

	2008年3月期 実績		2009年3月期 予想		前期比 増減率(%)
	金額	売上高比(%)	金額	売上高比(%)	
売上高	1,290,436	100.0	1,476,000	100.0	14.4
営業利益	152,420	11.8	145,000	9.8	-4.9
税引前当期純利益	174,842	13.5	165,000	11.2	-5.6
当期純利益	107,244	8.3	102,000	6.9	-4.9
希薄化後1株当たり 当期純利益(円)	565.80	—	537.91	—	-4.9
設備投資額	85,101	6.6	84,000	5.7	-1.3
減価償却費	75,630	5.9	90,000	6.1	19.0
研究開発費	61,605	4.8	72,000	4.9	16.9
平均為替レート	対ドル:114円	対ユーロ:162円	対ドル:100円	対ユーロ:155円	
為替の変動による 影響額(前期比)	売上高	59億円	-950億円		
	税引前 当期純利益	75億円	-200億円		

2009年3月期 第2四半期以降の見通し及び取組み（1）

ファインセラミック部品関連事業

- ・ 半導体製造装置市況の回復時期は不透明
- ・ 単結晶サファイア基板の増産
- ・ 自動車部品の拡販



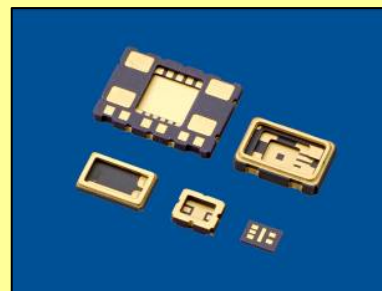
単結晶サファイア基板



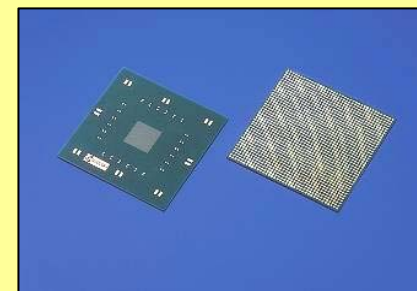
グロープラグ

半導体部品関連事業

- ・ セラミックパッケージ及び有機パッケージの売上拡大
(携帯電話端末、デジタル家電、サーバー関連向け)



水晶/SAW用
セラミックパッケージ



ASIC用
有機パッケージ

2009年3月期 第2四半期以降の見通し及び取組み（2）

ファインセラミック応用品関連事業

ソーラーエネルギー事業の拡大

- ・ 年間生産量300MW
- ・ バックコンタクトセルの量産準備
- ・ 売上高1,000億円を早急に目指す



太陽電池製造ライン



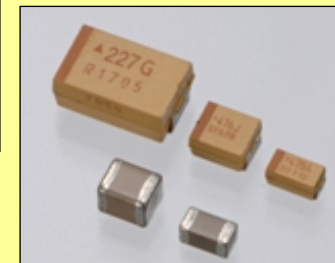
セル生産工場
(滋賀県八日市)

電子デバイス関連事業

- ・ 携帯電話用TCXO及び水晶振動子の拡販
- ・ コンデンサの収益改善
(新製品投入、生産性向上)



タイミングデバイス



各種コンデンサ

2009年3月期 第2四半期以降の見通し及び取組み（3）

通信機器関連事業

- 承継事業とのシナジーの追求
（事業戦略の策定、開発リソースの共有、製造コスト低減等）
- 次世代PHS基地局の開発と生産体制の準備
- WiMAX事業の基地局開発



情報機器関連事業

- 新製品投入による収益の拡大
- 米国景気の回復時期は不透明

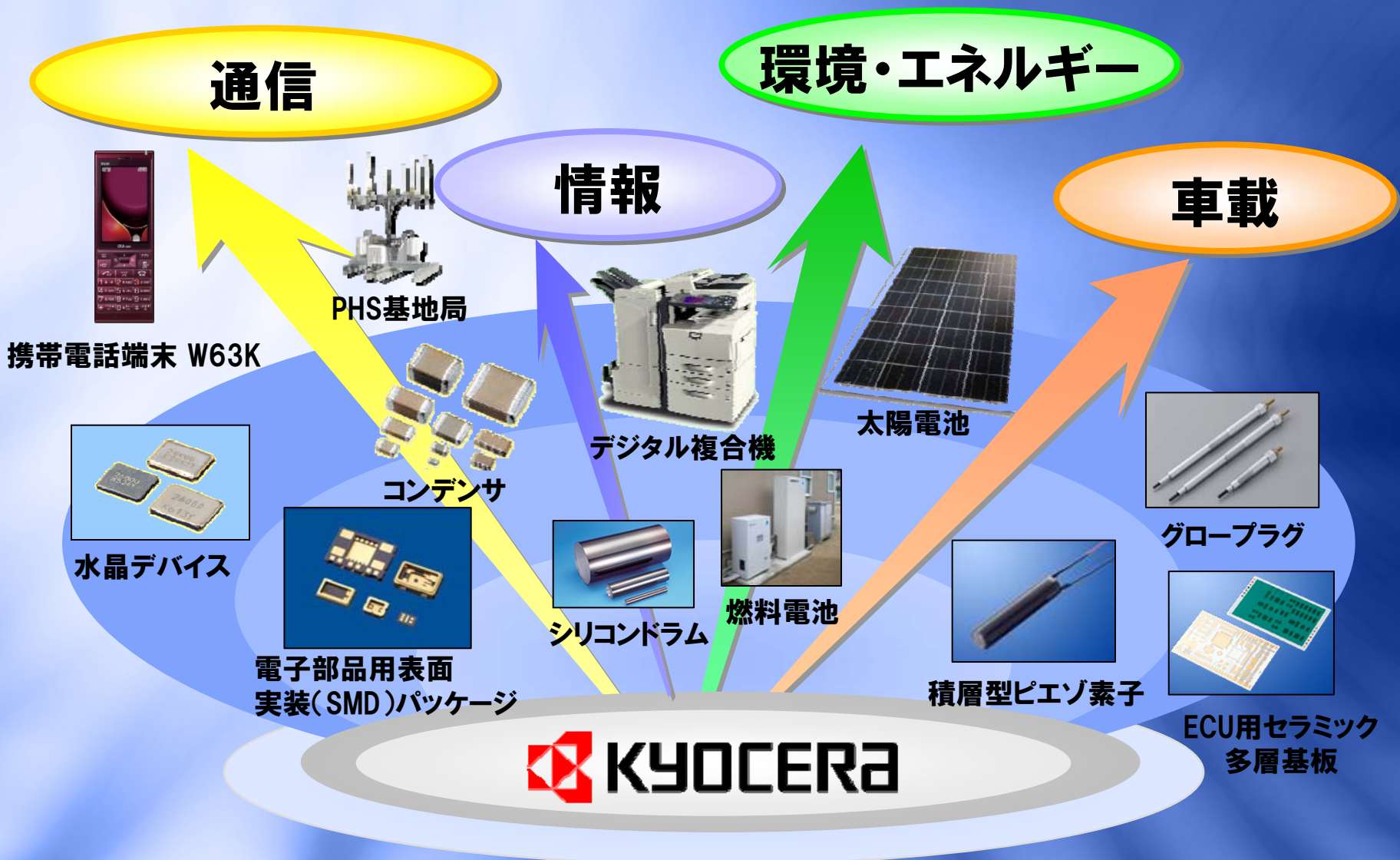


カラーデジタル複合機
KM-C4035E



京セラミタ(株)
R&Dセンター

重点市場での事業拡大を推進



持続的な収益拡大を目指す



重点市場

通信

情報

環境・
エネルギー

車載

京セラ株式会社
2009年3月期 第1四半期事業説明会

半導体部品事業の展開

取締役 執行役員専務
ファインセラミック事業本部長
兼 半導体部品事業本部長

久芳 徹夫

2009年3月期 第1四半期の実績

(単位:百万円)

	2008年3月期 第1四半期	2009年3月期 第1四半期	前年同期比 増減率
売上高	35,277	41,167	16.7%
税引前利益	4,023	6,198	54.1%
税引前利益率	11.4%	15.1%	+3.7P

➤ セラミックパッケージ関連

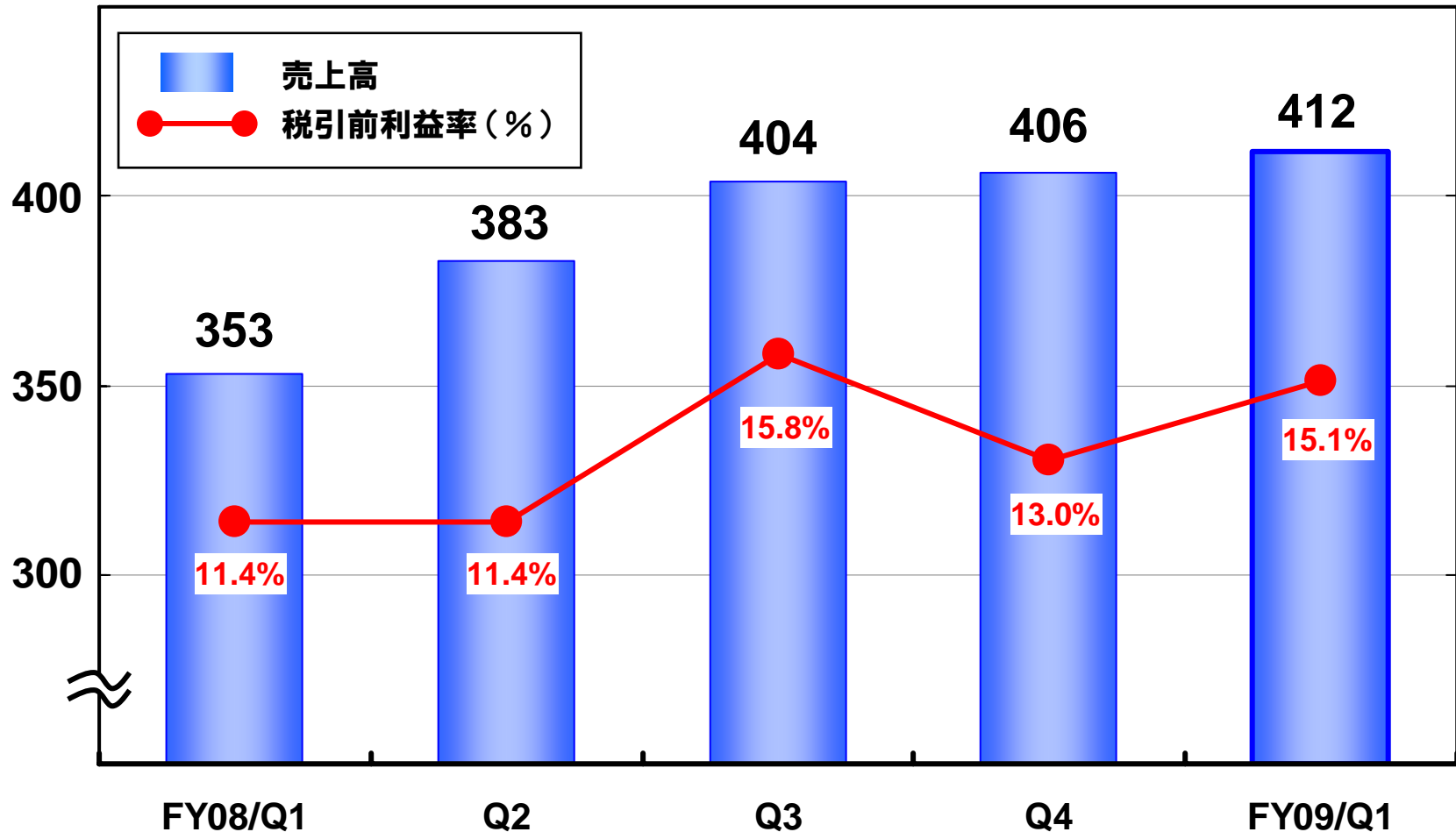
- ・ 水晶／SAW用パッケージ、CCD／CMOS用パッケージの売上増加

➤ 有機パッケージ関連

- ・ ASIC用パッケージの売上増加、前期第3四半期より黒字化

半導体部品事業 四半期売上高・税引前利益率の推移

(単位:億円)



市場用途別 売上構成比

- セラミック製品
- 有機製品

新市場

- 車載、その他

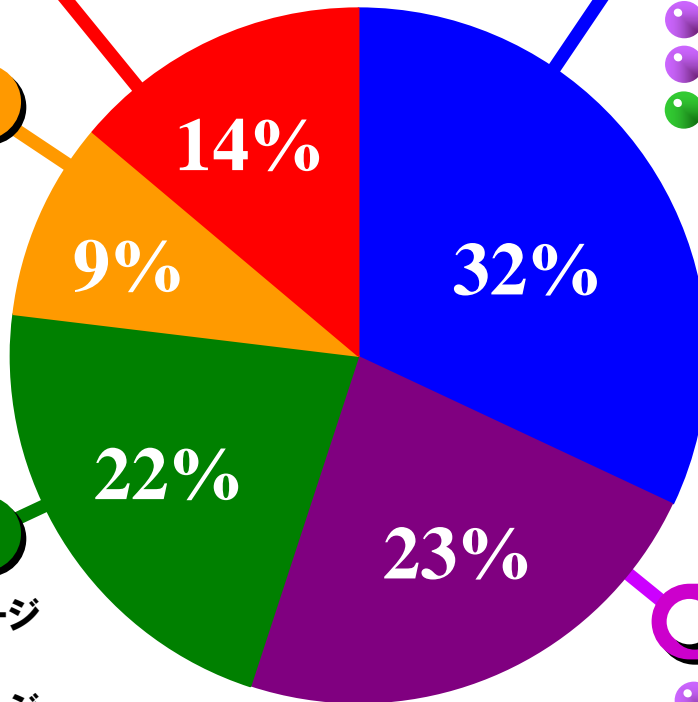
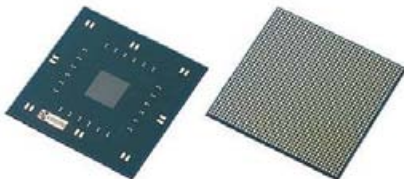
通信インフラ関連

- LD/PD用パッケージ
- 光コネクタ部品



サーバー関連

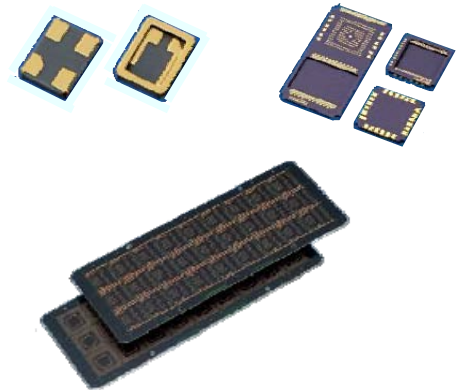
- ASIC用フリップチップパッケージ (セラミック)
- ASIC用フリップチップパッケージ (有機)



2008年3月期実績

携帯電話端末関連

- 水晶/SAW用パッケージ
- CMOSイメージセンサ用パッケージ
- 高周波通信モジュール用パッケージ
- SiP(システムインパッケージ)基板

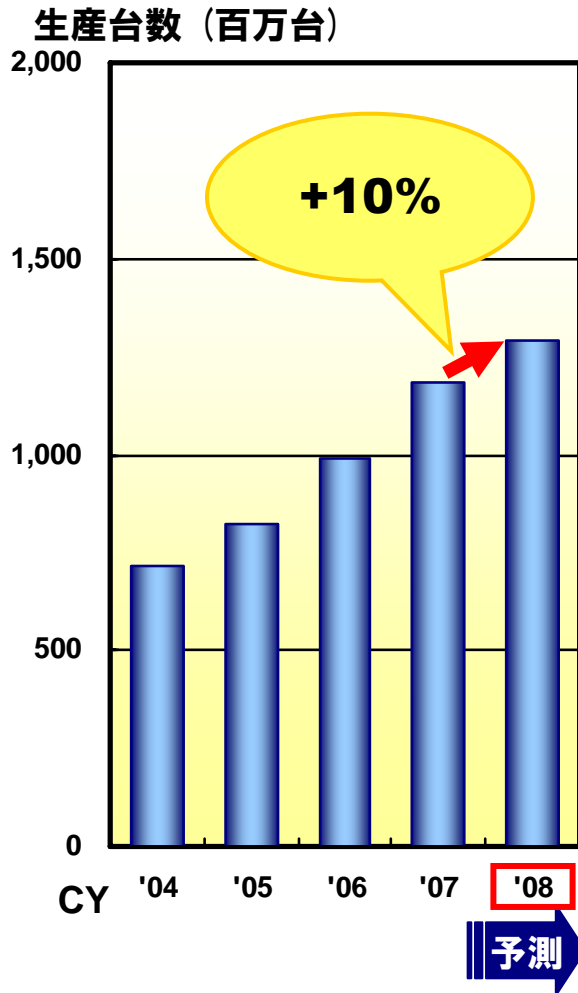


デジタル家電関連

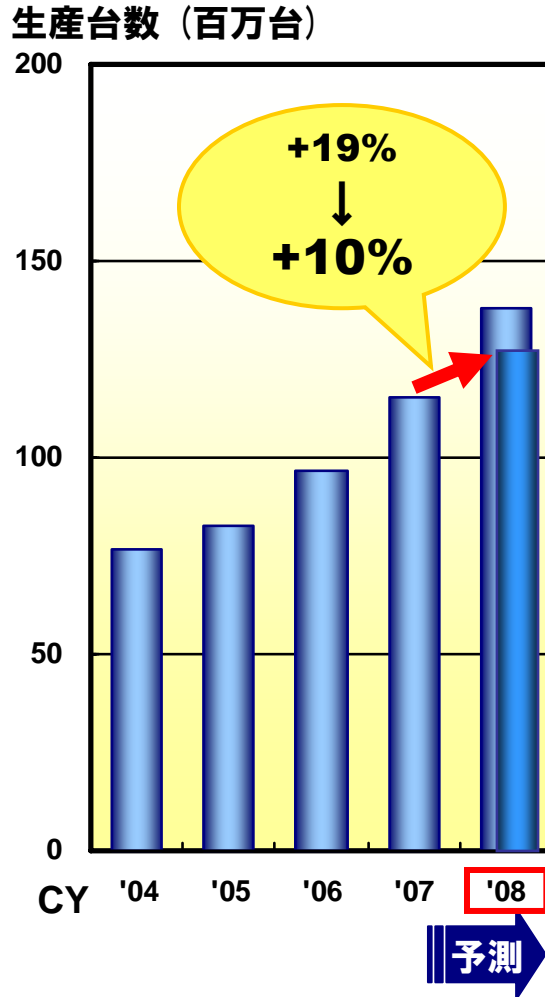
- 水晶/SAW用パッケージ
- CCD/CMOSイメージセンサ用パッケージ
- ゲーム機用フリップチップパッケージ
- SiP(システムインパッケージ)基板

半導体部品事業を取り巻く市場環境

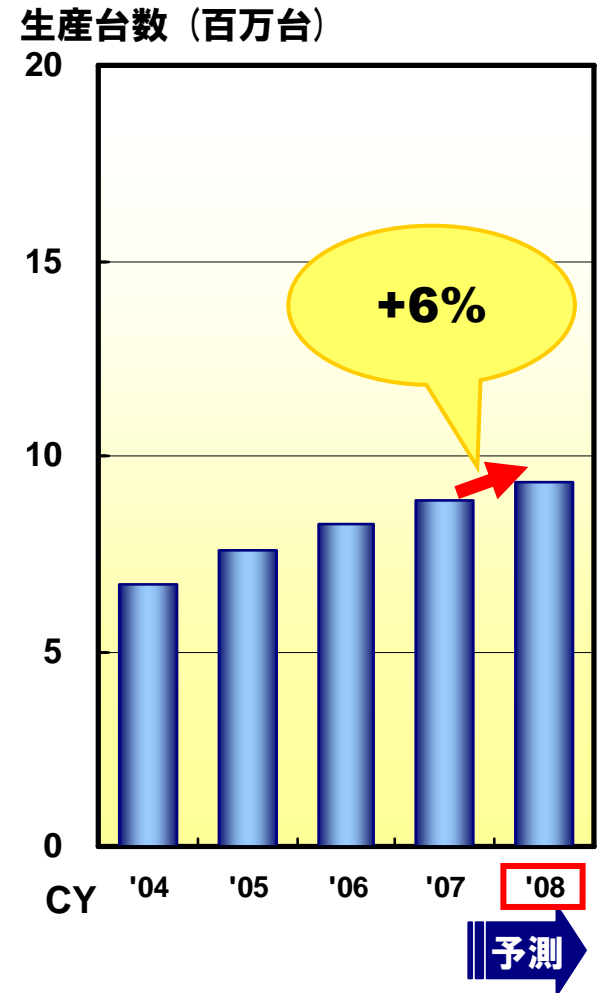
携帯電話端末



デジタルカメラ



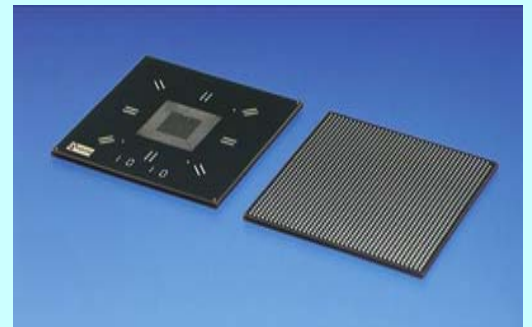
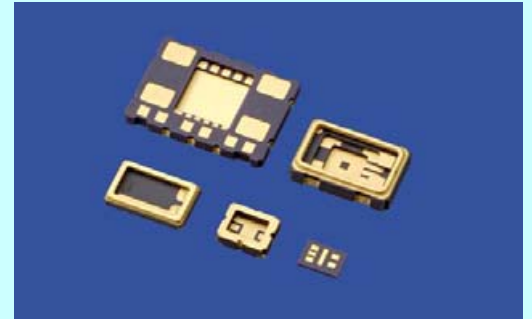
サーバー



半導体部品事業の取り組み

主力市場での売上拡大

- 1** 携帯電話端末市場
- 2** デジタル家電市場
- 3** サーバー関連市場



新市場開拓

- 4** 車載、医療機器、環境関連商品への展開


1 携帯電話端末市場での売上拡大

● 現状搭載商品


● セラミック製品

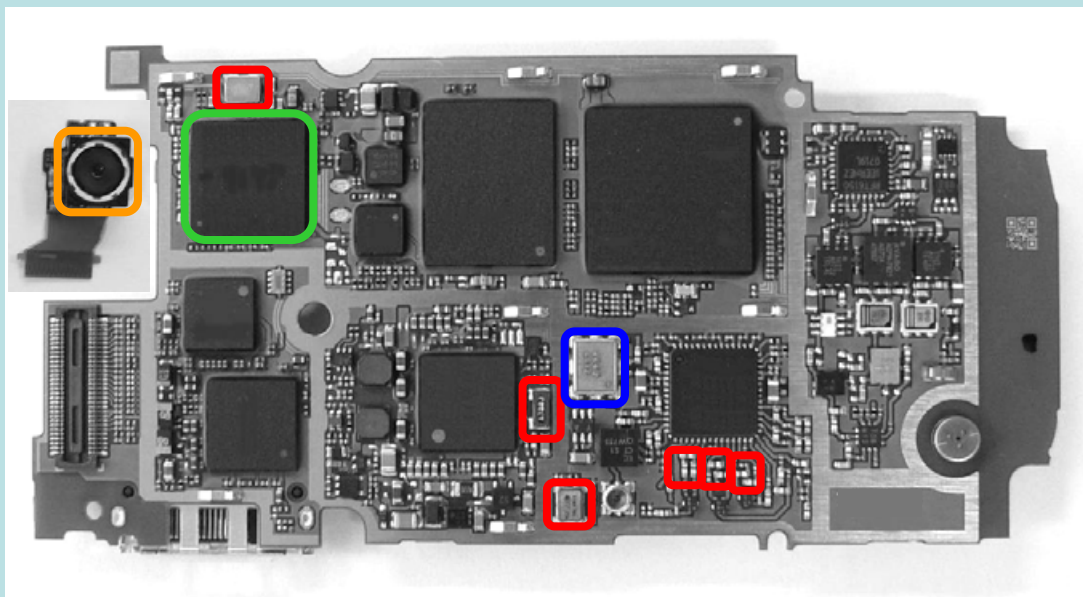
 水晶/SAW用パッケージ

 CMOSイメージセンサ用パッケージ

 高周波通信モジュール用パッケージ

● 有機製品

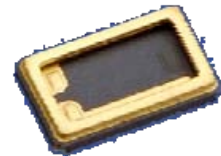
 アプリケーションプロセッサ用SiP基板



● 新規搭載商品

キャパシタ用パッケージ、マイク用パッケージ、その他新規アプリケーションに拡大

1 携帯電話端末市場での売上拡大



● 水晶／SAW用パッケージの展開

■ 技術トレンド：市場ニーズ

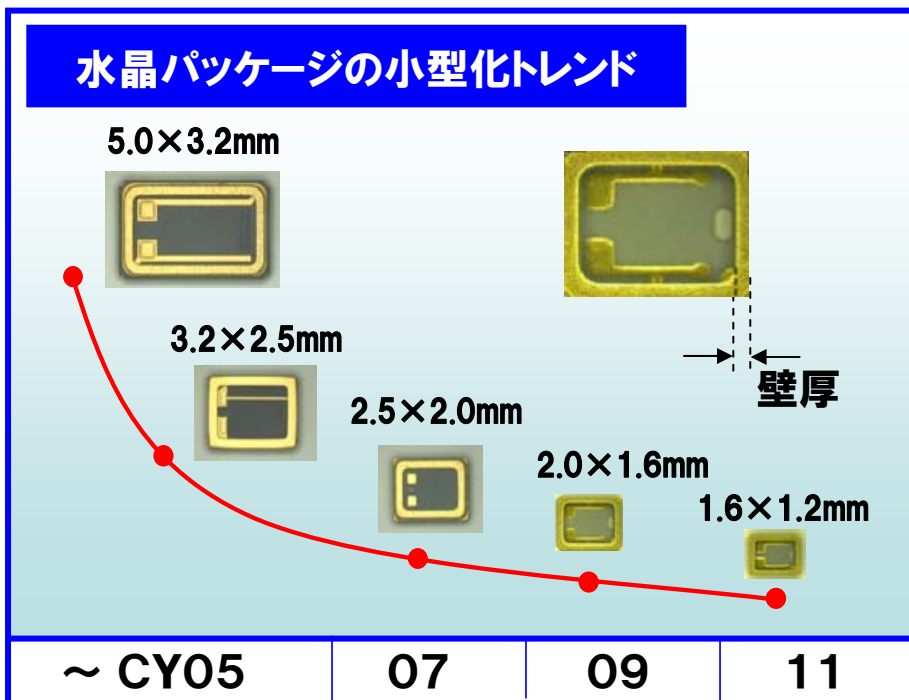
機器の小型・薄型化
電子部品の小型化

■ 京セラの強み

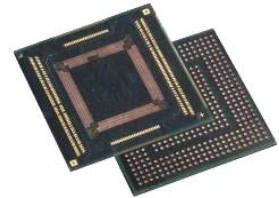
**高いマーケットシェアによる
最先端情報入手**

高強度材料開発力

高信頼性確保



1 携帯電話端末市場での売上拡大



● 有機SiP(システムインパッケージ)基板の展開

■ 技術トレンド:市場ニーズ

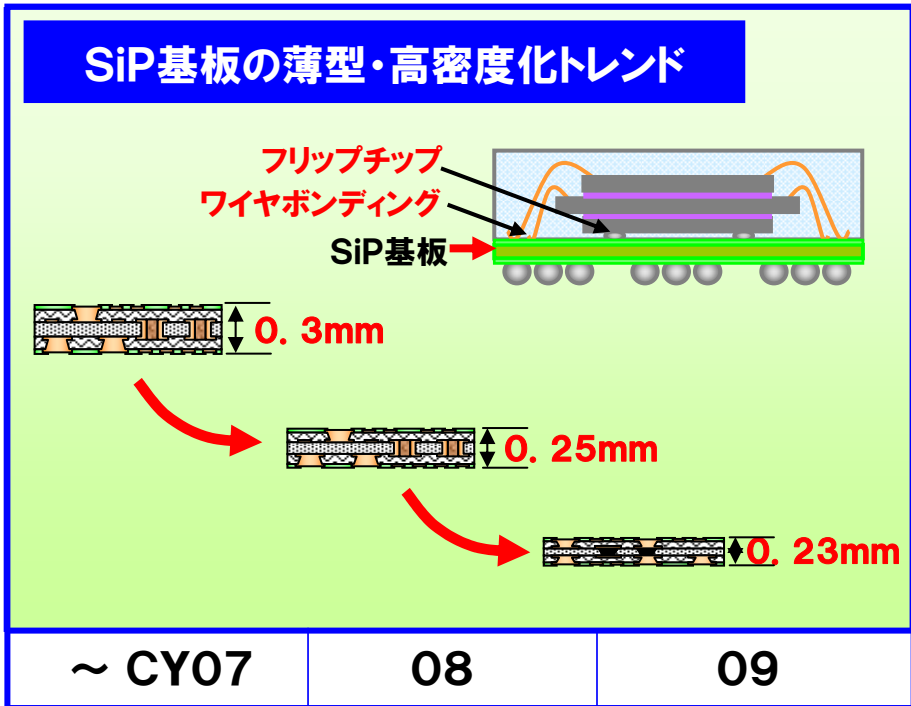
■ 京セラの強み

機器の小型・薄型化
半導体の高密度実装化

薄型基板の生産技術力

表面処理技術

微細配線技術



2 デジタル家電市場での売上拡大

● 積極的な用途・商品開拓を展開する

デジタルカメラ



ゲーム機



薄型テレビ

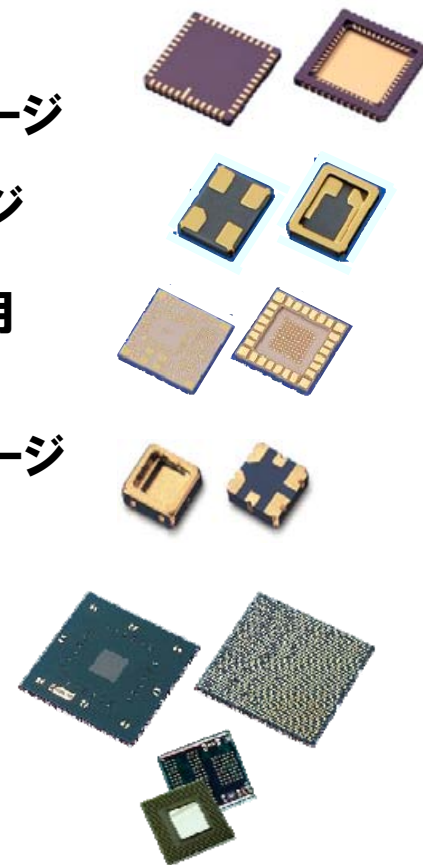


● セラミック製品

- CCD/CMOS
イメージセンサ用パッケージ
- 水晶/SAW用パッケージ
- 高周波通信モジュール用
パッケージ
- ジャイロセンサ用パッケージ

● 有機製品

- CPU/GPU用パッケージ
- SiP用パッケージ



3 サーバー関連市場での売上拡大

● 当社の強み

① 強固な顧客関係

- 半導体産業勃興期からのパッケージ供給実績
- マーケットシェア No.1

② 高性能パッケージ技術

- 優れた電気特性設計技術
- 微細配線技術・多層化技術
- セラミックス材料開発力

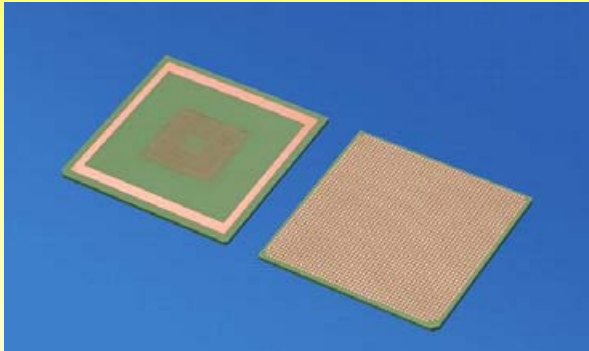
3 サーバー関連市場での売上拡大

● さらなる高性能化の追求

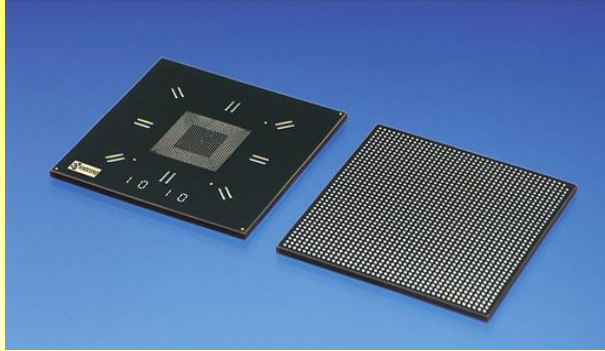
多ピン化

狭ピッチ化

高速伝送化



セラミック・フリップチップパッケージ



有機・フリップチップパッケージ

- 強みの維持によるマーケットリーダーポジションの堅持
- セラミックの材料特性を活かした展開

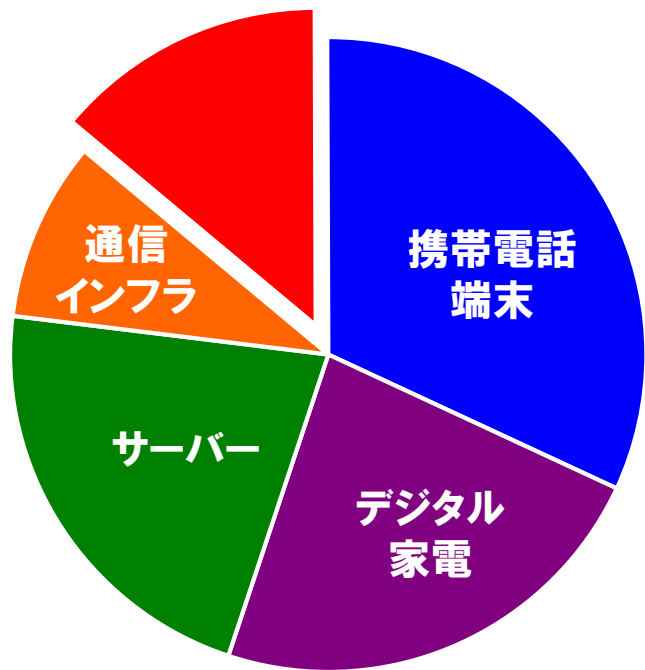
▶ チップの大型化 ▶ 実装信頼性確保

- 熱膨張係数の最適化
- 優れた剛性

} **高信頼性を実現**

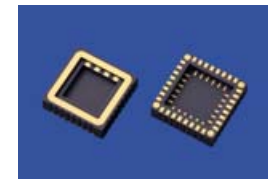
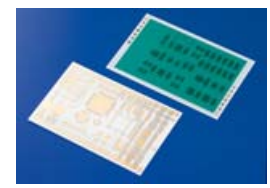
4 新市場開拓：車載、医療機器、環境関連商品への展開

新市場



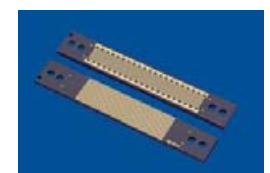
■ 車載向けアプリケーション

- 各種ECU用基板
- 各種センサ用パッケージ
- ミリ波レーダー用パッケージ



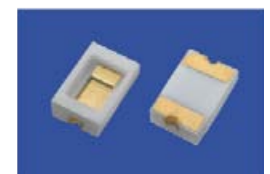
■ 医療機器向けアプリケーション

- CTスキャナ用基板
- 内視鏡用パッケージ



■ 環境関連商品向けアプリケーション

- LED用パッケージ



4 新市場開拓：車載、医療機器、環境関連商品への展開

● 車載セラミック基板・パッケージ展開

■ 市場ニーズ

- 環境・低燃費
- 安全性
- 快適・利便性

エレクトロニクス化の
急激な加速

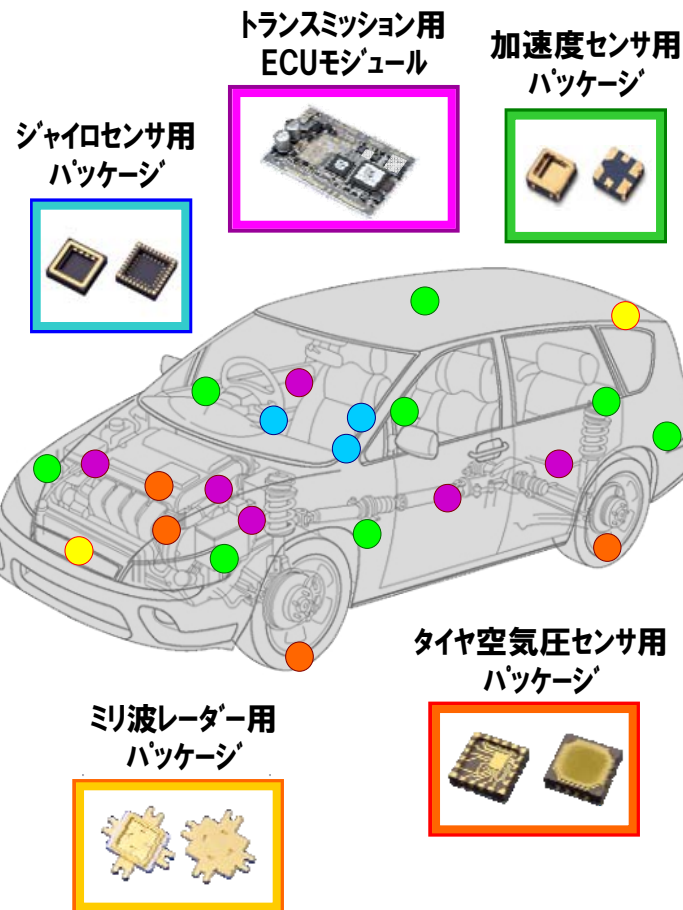
■ アプリケーション例

● 各種ECU基板

● 耐熱性

- 加速度センサ用パッケージ
- ジャイロセンサ用パッケージ
- 圧力センサ用パッケージ
- ミリ波レーダー用パッケージ

● 気密性
● 小型化



半導体部品事業の今後の展開



京セラグループの総合力を活用し、積極的な事業展開を図る

セラミック材料・有機材料の特徴を活かし
さらなる事業拡大をめざす

京セラ株式会社
2009年3月期 第1四半期事業説明会

情報機器事業の展開

京セラミタ株式会社
代表取締役社長
駒口 克己

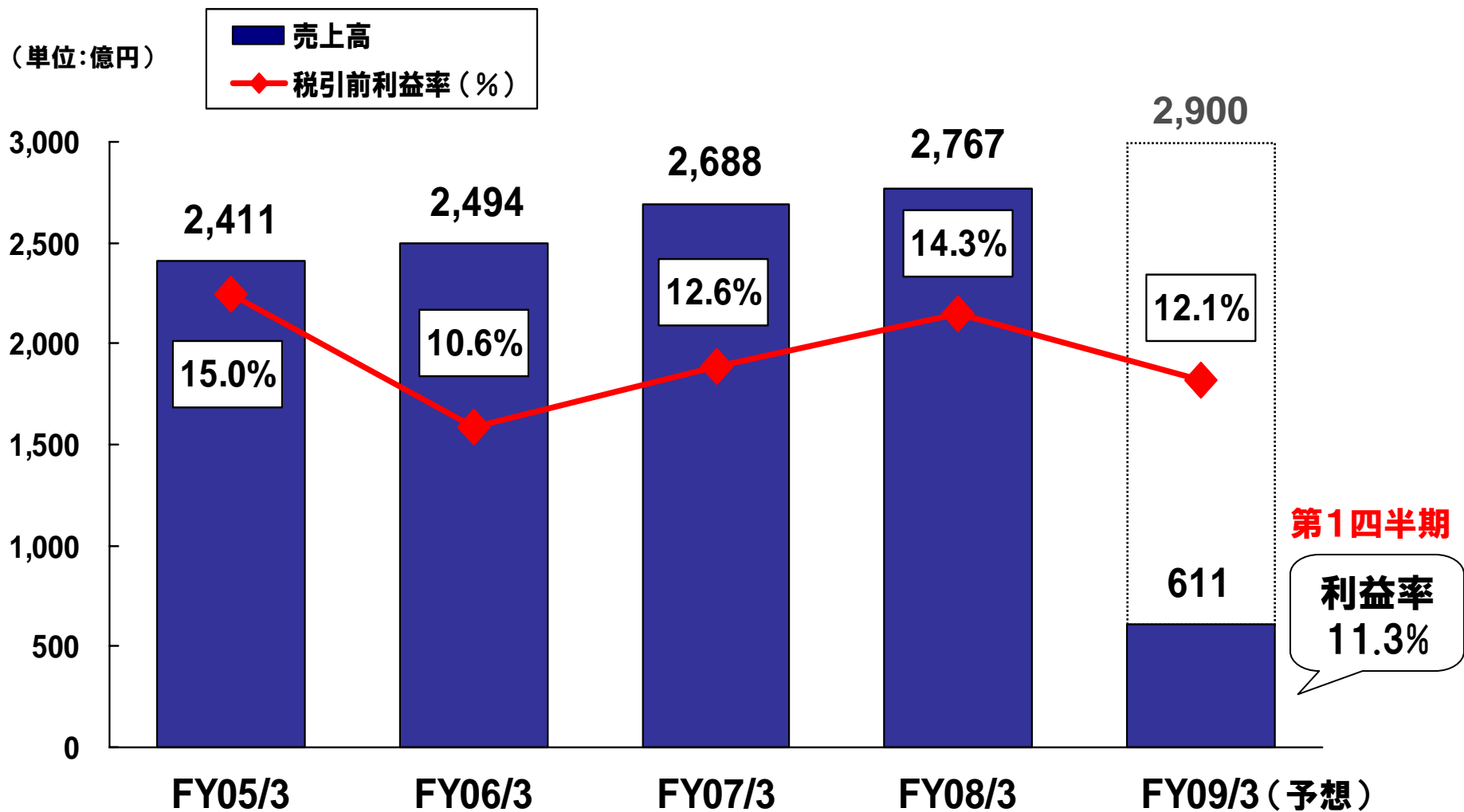
2009年3月期 第1四半期の実績

(単位:百万円)

	2008年3月期 第1四半期	2009年3月期 第1四半期	前年同期比 増減率
売上高	67,272	61,114	-9.2%
税引前利益	9,406	6,887	-26.8%
税引前利益率	14.0%	11.3%	-2.7P

- ・ 米国市場景気減速によるオフィス機器への投資減退の影響から情報機器の需要が伸び悩み、価格競争が激化
- ・ プラスチックや鉄材などの原材料が高騰

売上高・税引前利益率の推移

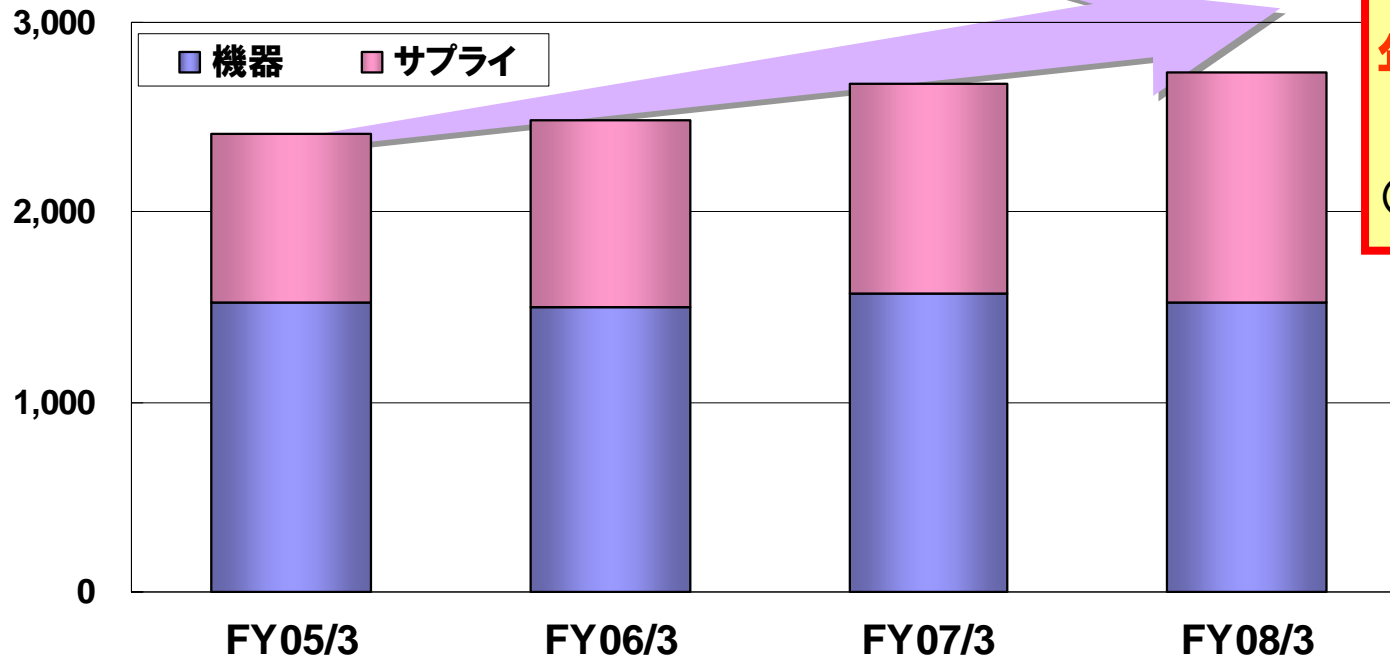


情報機器関連事業の成長と拡大

カラー消耗品の売上拡大により安定的な利益成長を果たす

(単位:億円)

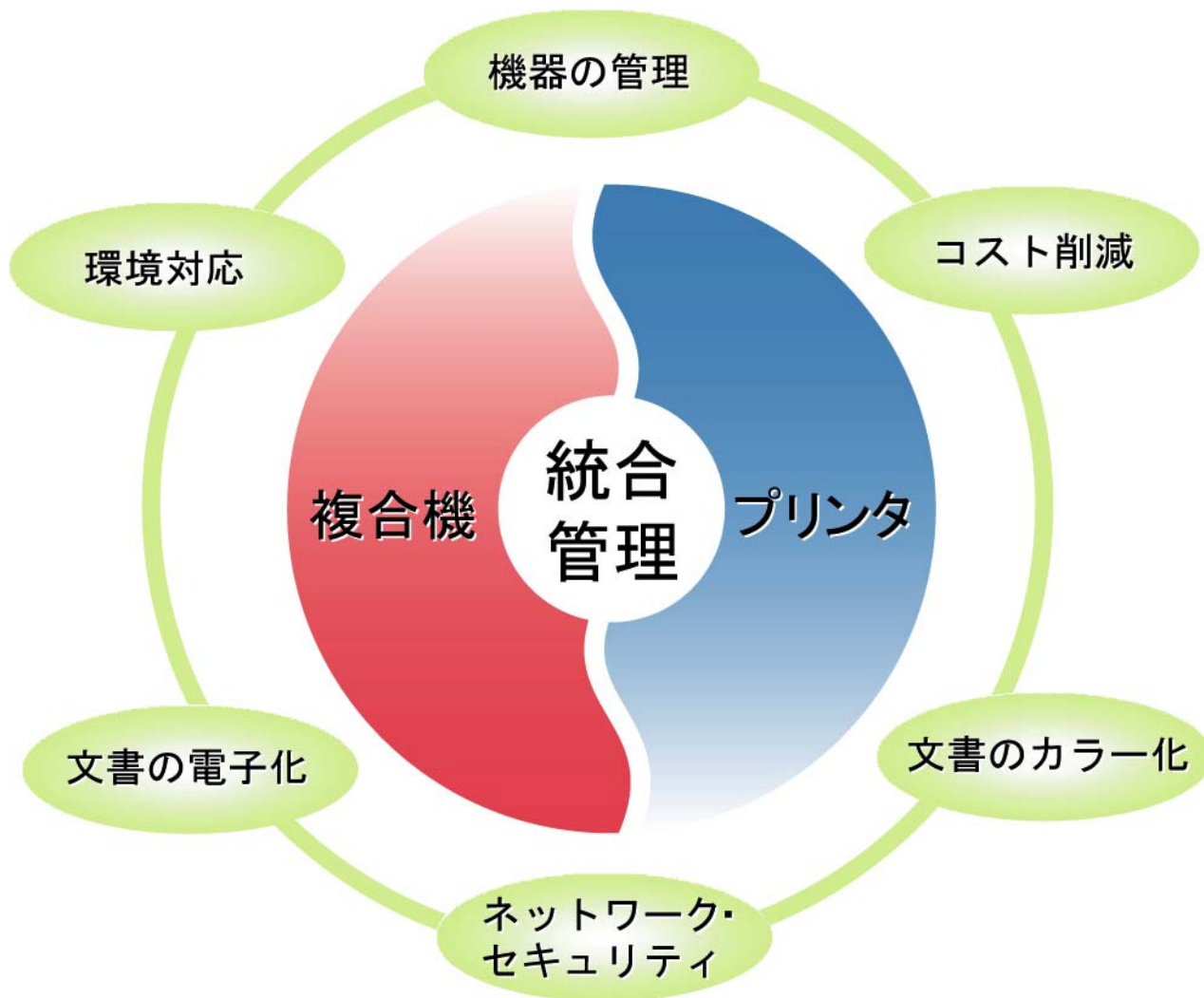
情報機器関連事業売上高推移



年平均成長率 約5%
サプライ全般 約11%
(うちカラーサプライ 約25%)

◆ **FY05~FY08 年平均成長率** : **約5%**
 ➤ **サプライ(消耗品、パーツ、サービス)** : **約11%**
 ・ **カラー消耗品は年率25%成長、今後更に加速**
 ・ **カラー消耗品の付加価値は高い(高収益)**

企業顧客の統合管理ニーズの拡大



事業拡大に向けての取組み

カラー製品の設置台数増加とカラー消耗品の収益最大化

1. カラーエンジン・プラットフォームの開発

2. コントローラ・プラットフォームの開発

3. 新カラートナー開発とプラントへの設備投資

カラーエンジン・プラットフォームの開発

進化する“エコシス”コンセプト

カラー製品の設置台数増加とカラー消耗品の収益最大化

Long Life Technology
長寿命化技術

ECOSYS
エコシス

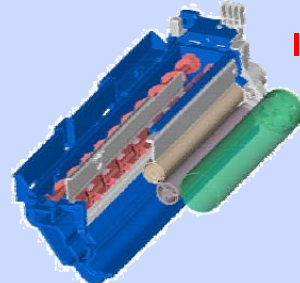
Ecology
環境性

System
システム

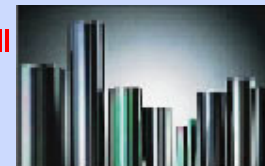
Economy
経済性

独自のカラー技術

独自のインタラクティブ
タッチダウン現像法
(高画質、長寿命)



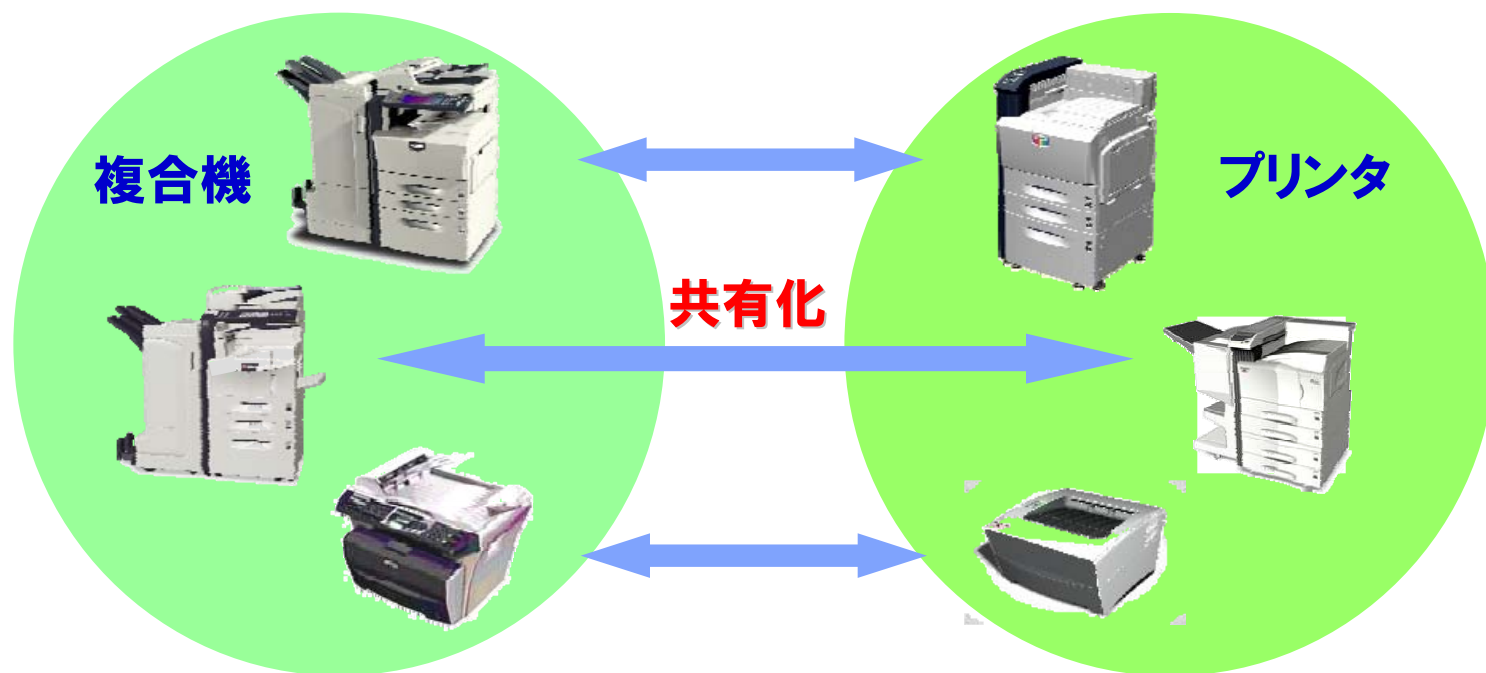
a-Si感光体
(長寿命、高信頼性)



KM-C4035E
(Voyager series)

エンジン・プラットフォームの共有化

複合機とプリンタのエンジン・プラットフォームの共有化は京セラミタ独自の開発戦略、この強みを活かす



エンジン・プラットフォーム共有化のメリット

- ・開発リソース共有
- ・生産技術共有
- ・資材調達とコスト
- ・サービス体制
- ・販売戦略

コントローラ・プラットフォームの開発

プリンタ・コントローラ

複合機コントローラ

自社開発
コントローラ

サードパーティー開発
コントローラ

CY2001
自社プリンタ・コントローラの
複合機への導入

CY2004
自社開発
WiseCoreコントローラ

CY2008
ピアレス社
知財の買収

CY2008
WiseCoreコントローラのカラー機器への展開

- プリンティング環境の共通化
 - ドライバ、ネットワークなど
- カスタマイズ対応力の強化
- ドキュメント・ソリューション対応力の強化
- セキュリティ・ソリューションの強化

- カラー処理技術の強化

共通化のメリット

- 企業顧客の統合ニーズへの対応力の強化
 - セキュリティ、Webサービスなどの共通化
- コントローラ技術のプラットフォーム化による開発のスピードアップ

新カラートナー開発とプラントへの設備投資

玉城工場：新トナープラント建設
2008年5月稼働

カラー技術開発強化

- ・ 高画質カラートナーの開発
- ・ 小粒径、形状制御トナー
- ・ トナー増産体制





2008年5月竣工
R&Dセンター

THE NEW VALUE FRONTIER



京セラ株式会社